## Produktdatenblatt **Technische Daten**

# BMEH584040C

Redundante HSBY-Prozessormodule M580, Stufe 4, Dezentral , beschichtet

EAN Code: 3606485440002





### Hauptmerkmale

| Produktserie                | Modicon M580               |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Produkt oder Komponententyp | Redundante Prozessormodule |  |
| Imprägnierungsmaterial      | Schutzlack                 |  |

### Zusatzmerkmale

| Anzahl von Racks                | 1   |
|---------------------------------|---|
| Anwendungspezifischer E/A       | Genaue Zeitstempelung HART Zähler SSI-Encoder Serielle Schnittstelle Motion Control   |
| Prüfungen                       | Prozesssteuerung  |
| Steuerkanäle                    | Programmierbare Regelkreise   |
| Integrierte Schnittstellen      | 1 Ethernet TCP/IP für Service-Port<br>2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk<br>USB Typ Mini-B<br>1 Ethernet für HSBY-Port  |
| Anzahl entfernter E/A-Stationen | 16 - 2 Einbaugehäuse pro X80 und Quantumabfall  |
| Anzahl verteilter Geräte        | 64  |
| Kommunikationsmodulprozessor    | 8 AS-Interface-Modul<br>4 Ethernet-Kommunikationsmodul  |
| Kommunikationsdienst            | DIO-Scanner<br>RIO-Scanner  |
| Speicherbeschreibung            | Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung<br>Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher<br>Integriert RAM, 16 MB für Programm<br>Integriert RAM, 2048 kB für Daten |
| Anwendungsstruktur              | 1 periodische Fast Task<br>1 zyklisch/periodische Master Task   |
| Anzahl der Anweisungen pro ms   | 30 kAnw/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch   |

## 40 kAnw/ms 100 % boolesch

| Leistungsaufnahme    | 295 mA bei 24 V DC |
|----------------------|--------------------|
| MTBF Zuverlässigkeit | 600000 H           |
| Beschriftung         | CE                 |

## Montage

| Montage                          |  |
|----------------------------------|--|
| Vibrationsfestigkeit             | 3 gn   |
| Stoßfestigkeit                   | 30 gn  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -2560 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -4085 °C   |
| Aufstellungshöhe                 | 02000 m<br>20005000 m mit  |
| Relative Feuchtigkeit            | 595 % bei 55 °C ohne Kondensation  |
| Schutzart (IP)                   | IP20   |
| Richtlinien                      | 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie<br>2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit<br>2012/19/EU - WEEE-Richtlinie  |
| Normen                           | EN 61131-2<br>EN 61000-6-4<br>EN 61000-6-2<br>EN 61010-2-201   |
| Schutzbehandlung                 | Conformal coating  |
| Umgebungsbedingungen             | Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Staubbeständig class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant Stufe 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2   |
| Produktzertifizierungen          | EAC IEC-Ex ATEX Handelsmarine CSA RCM UL CE  |
| Versorgung                       | Interne Stromversorgung über Modulträger   |
| Status-LED                       | 1 LED (grün)Prozessor in Betrieb (RUN): 1 LED (rot)Prozessor- oder Systemfehler (ERR): 1 LED (rot)I/O Modulfehler (I/O): 1 LED (grün)Downloadvorgang aktiv (DL): 1 LED (rot)Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP): 1 LED (grün/rot)ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen): 1 LED (grün/rot)Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus): 1 LED (grün)Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN): 1 LED (grün)Prozessor-ID Satz bis A (A): 1 LED (grün)Prozessor-ID Satz bis B (B): 1 LED (grün)Prozessor primär (PRIM): 1 LED (grün)Prozessor Standby (STBY): 1 LED (grün)E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO): 1 LED (grün)Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag): |
| Produktgewicht                   | 0,849 kg   |

## Nachhaltigkeit

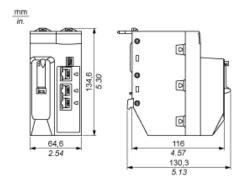
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
|-------------------------------------|---|
| REACh-Verordnung                    | REACh-Deklaration   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung für China  |
|                                     |   |

| Circular Econmomy-Eignung   | Entsorgungsinformationen  |
|-----------------------------|---|
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Vertragliche Gewährleistung |   |
| Garantie                    | 18 Monate   |

# Produktdatenblatt Maßzeichnungen

# BMEH584040C

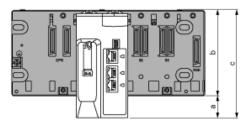
## Nur CPU-Module



## Produktdatenblatt Maßzeichnungen

# BMEH584040C

## Auf Racks montierte Module

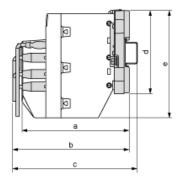


- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack bie Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

## Produktdatenblatt Maßzeichnungen

# BMEH584040C

### In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.) a:
- b:
- C:
- Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)

  Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)

  Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.) d:
- Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.) e: